

JP1166545

Publication Title:

ZIGZAG TYPE IC

Abstract:

Abstract of JP1166545

PURPOSE:To facilitate the formation of a pattern on a printed substrate by forming a structure of leads corresponding to surface mounting technique.
CONSTITUTION:The leads at both ends of an IC body 1 are composed of leads 2 to be soldered to prevent an IC from overturning, and other leads are formed of leads 3, 4 for a surface mounting technique, and disposed in a zigzag state. When a zigzag type IC is mounted on a printed substrate, the leads 2 are inserted to through holes, and other leads are solderconnected by cream-solder on pads formed on the substrate. Thus, the formation of a pattern on the substrate can be facilitated.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

⑪ Int. Cl.

H 01 L 23/50

識別記号

庁内整理番号

N-7735-5F

⑬ 公開 平成1年(1989)6月30日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

⑭ 発明の名称 ジグザグ型IC

⑮ 特 願 昭62-326183

⑯ 出 願 昭62(1987)12月22日

⑰ 発 明 者 山 内 節 美 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内
⑱ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号
⑲ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

1. 発明の名称

ジグザグ型IC

2. 特許請求の範囲

IC本体と、前記IC本体の両端に設けられた半田付用リードと、表面実装のために千鳥状に配置された表面実装技術用リードとを含むことを特徴とするジグザグ型IC。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はジグザグ型IC、特に、電子機器に使用されるジグザグ型ICに関する。

〔従来技術〕

従来のジグザグ型ICは第2図に示すようにプリント基板に接続するものにも半田付用リードで接続していた。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながらこのような上述した従来のジグザグ型ICは半田付用リードのため、実装パターンが引きずらいという欠点がある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明のジグザグ型ICは表面実装技術用リードを含んで構成される。

〔実施例〕

次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す斜視図である。

第1図に示すジグザグ型ICは、IC本体1の両端のリードが半田付用リード2となり、ICの転倒を防いでいる。

他のリードは表面実装技術用リード3、4であり、これらは互いに千鳥状となるように配置されている。

プリント基板にジグザグ型ICを実装する時は、スルーホールに半田付用リード2を挿入し、ICの転倒を防ぎ、他のリードはプリント基板上につくられたパッド上にクリーム半田により半田接続

される。

〔発明の効果〕

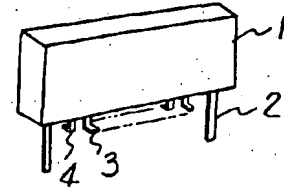
本発明のジグザグ型ICは表面実装技術に対応したリードの構造にすることによりプリント基板上でのパターンを作成しやすいという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

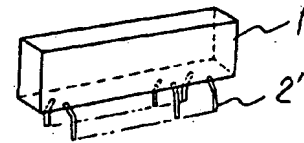
第1図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2図は従来の一例を示す斜視図である。

1……IC本体、2、2'……半田付用リード、3、4……表面実装技術用リード。

代理人 弁理士 内 原 晋



第1図



第2図